



化合物半導体の製品開発・プロセス開発エンジニア（SiC）

東芝デバイス ストレージ株式会社での募集です。商品企画・商品開発（技術系）の...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

東芝デバイス ストレージ株式会社

Job ID

1467827

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Hyogo Prefecture

Salary

4.5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 ※初年度は入社月によって変動。半日取得可、最大24日付与、繰越制度あり。【休日】...

Refreshed

May 10th, 2024 13:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2116632】

【業務内容】

パワーデバイス（主にSiC）の製品開発・デバイス設計・プロセス・エビ技術・装置開発

■製品開発

- ・デバイス設計・シミュレーション（TCAD）
- ・試作・性能評価・解析
- ・量産立上業務

■プロセス開発

- ・ SiCデバイスのプロセスインテグレーション
- ・ SiCデバイスのユニットプロセス開発
- ・ SiCのエピプロセス 装置開発

【参考リンク】

・ スペシャルインタビュー～あなたのキャリアが世界を変える～
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/recruit/work/message_special.html

・ パワー半導体技術広告
<https://www.youtube.com/watch?v=11SWvEW4lQ>

Required Skills

【必須】 ・ 製品開発／プロセス開発／生産技術／歩留改善／パッケージ技術／材料開発／品質保証／評価・解析／製品テスト（いずれかの経験） ・ デバイス開発は、パワーデバイス（SiC等）のチップ設計、開発に従事された経験のある方 【尚可】 （１）デバイス開発 ・ TCADシミュレーションに関する知識をお持ちの方 （２）プロセス開発 ・ 半導体デバイスメーカーでプロセスインテグレーション、あるいはユニットプロセス開発に従事された経験のある方 ・ 半導体製造装置メーカーで装置開発、あるいはプロセス開発に従事された経験のある方 ・ 半導体ウェハメーカーでプロセス開発（特にエピタキシャル成長プロセス）または装置開発に従事された経験のある方

Company Description

ディスクリート半導体、システムLSI、HDD及び関連製品の開発・生産・販売事業並びにその関連事業